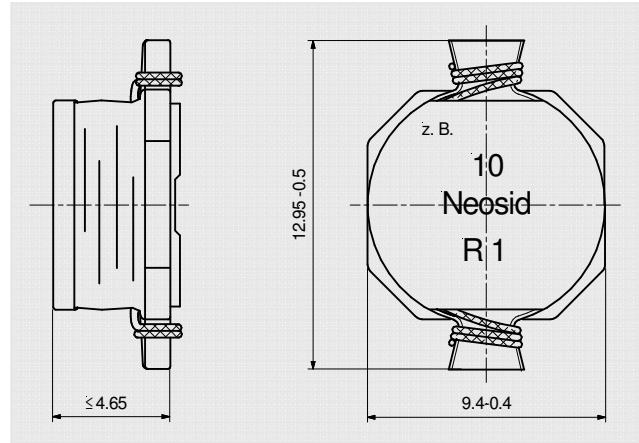


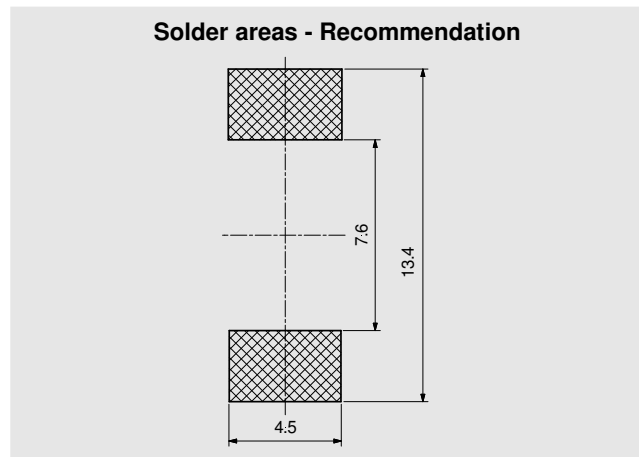
Series Ms 95T; Choke for ambient temperature up to 150°C

L	±	R ≤	I _{max}	f _{res} ≥	part number
[μH]	%	[Ω]	[A]	[MHz]	
1	30	0.007	8.0	90	88804400
1.5	30	0.009	6.6	47	88804401
2.2	25	0.011	5.6	37	88804402
3.3	25	0.013	4.8	32	88804403
4.7	25	0.015	4.0	28	88804404
5.6	25	0.018	3.6	24	88804405
6.8	25	0.022	3.0	22	88804406
10	25	0.03	2.5	20	88804407
12	25	0.036	2.2	17	88804408
15	25	0.04	2.1	15	88804409
18	25	0.058	1.9	13	88804410
22	25	0.062	1.7	11	88804411
33	25	0.095	1.4	9	88804412
39	25	0.11	1.2	7.5	88804413
47	25	0.115	1.1	7	88804414
56	25	0.15	0.9	6.5	88804415
68	25	0.16	0.84	6	88804416
82	25	0.22	0.82	5.5	88804417
100	15	0.24	0.8	4.5	88804418
120	15	0.33	0.76	4.2	88804419
150	15	0.35	0.73	3.8	88804420
180	15	0.5	0.7	3.2	88804421
220	15	0.55	0.64	2.8	88804422
270	15	0.69	0.62	2.5	88804423
330	15	0.79	0.57	2.2	88804424
390	15	0.88	0.53	1.9	88804425
470	15	0.95	0.46	1.7	88804426
560	15	1.65	0.4	1.5	88804427
680	15	1.8	0.36	1.3	88804428
820	15	2.1	0.33	1.1	88804429
1000	15	2.3	0.3	0.9	88804430
1200	15	2.9	0.25	0.7	88804431
1500	15	3.2	0.23	0.6	88804432
1800	15	4.5	0.21	0.5	88804433
2200	15	5.0	0.2	0.4	88804434

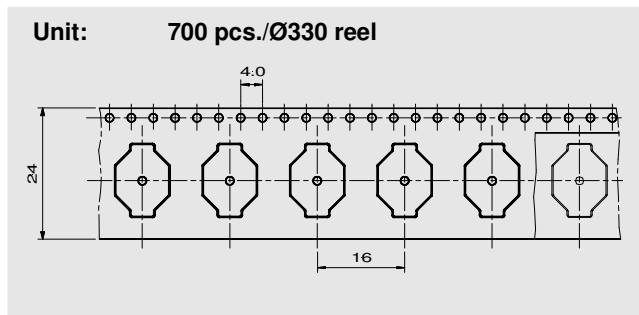
Dimensions and footprint (mm)



Solder areas - Recommendation



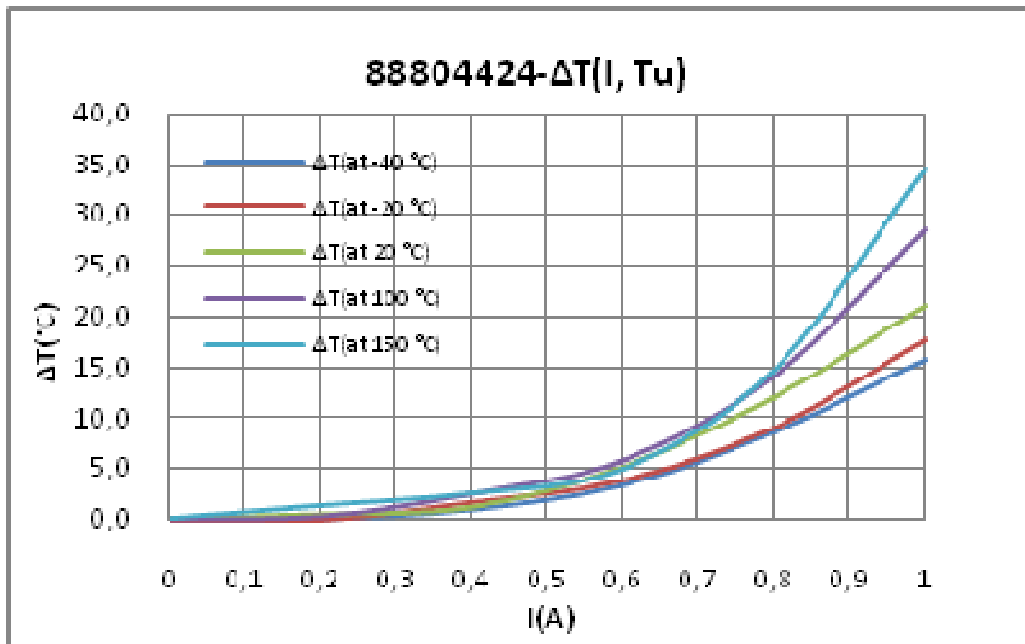
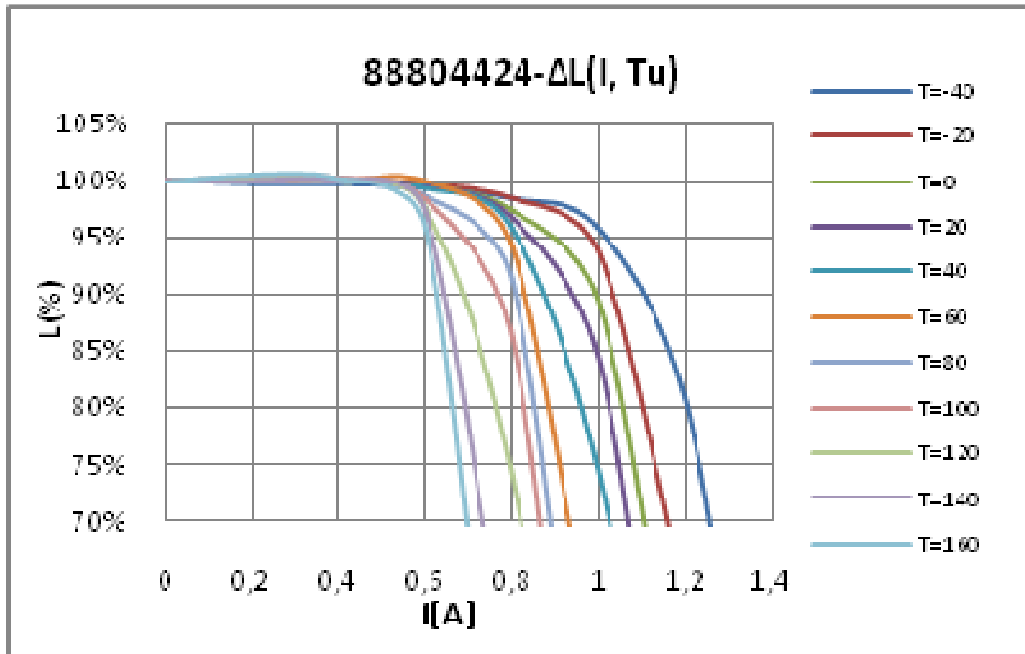
Packaging: Tape & reel



I_{max}: ΔL app. 10%; θ_ü ≤ 40°C. Other types on request.

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. No responsibility is taken for the correctness. Errors and changings reserved.

Example of measurement: Ms 95T/330 μ H



Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. No responsibility is taken for the correctness. Errors and changings reserved.

Einstück-Entwicklung SMD Induktivitäten

Lassen Sie die anderen kleben!

Das Kleben des Spulenkörpers auf eine Grundplatte ersparen wir uns. Stattdessen fertigen wir beide Teile in einem Stück.

Der Vorteil zeigt sich klar auf der Leiterplatte

Die kompakte Bauform dieser Reihe von Festinduktivitäten braucht ein Minimum an Platz. Ein weiteres Plus ist das Streufeld.

Auf lästige Fehlerquellen bei der Kontaktierung und an den Klebestellen verzichten wir dabei. Überflüssig sind dadurch auch die sonst üblichen metallclips, Metallisierungen oder Lötpins. Die Wickelenden der Spulendrähte werden dann noch verzinkt und bilden so gleichzeitig die Lötstellen. Damit bringen wir sie auf die Platine. Das war dann eigentlich schon alles.

Kennzeichen

- ✓ Kompakte Bauform
- ✓ Hohe Strombelastbarkeit
- ✓ Hohe Temperatur- und Schwingungsfestigkeit unter „Heavy-Duty“ Bedingungen
- ✓ AEC-Q200 Qualifikation
- ✓ Geringer Gleichstromwiderstand
- ✓ Automatisch bestückbar
- ✓ Für Reflow- und Dampfphasenlötung

Anwendungen

- ✓ Funkentstörung
- ✓ DC/DC Wandler
- ✓ AC/DC Wandler
- ✓ Entkopplung in HF- und ZF-Schaltungen
- ✓ Sicherheitssysteme in der KFZ Elektronik

One-piece – developments SMD inductors

Who needs glue?

We don't bother with gluing bobbins onto base plates any more. Instead, we fabricate both parts in one piece, as ferrite components.

The benefits are clear to see on any PCB

The compact design of this series of fixed inductors means they only require a minimum space

Using this method, we avoid troublesome sources of fault during bonding and at the gluing points. And the otherwise ubiquitous metal clips, soldering pins or plating are likewise all superfluous. The lead-out wires of the coil windings are then tinned and so simultaneously act as the soldering points. This is how we mount them on the circuit board. And that's all there is to it!

Features

- ✓ Compact design
- ✓ High current-load capacity
- ✓ High vibration and temperatures resistance under "Heavy Duty" conditions
- ✓ AEC-Q200 qualification
- ✓ Low DC resistance
- ✓ Suitable for automatic insertion
- ✓ For reflow and vapor phase soldering

Applications

- ✓ Radio interference suppression
- ✓ DC/DC- Power supply
- ✓ AC/DC Power supply
- ✓ Decoupling in RF-circuits
- ✓ Safety devices in automotive electronics

